		_				1		О	CT 11.	.040.019-83	Рорма 4			
													12	
														1
											МИЭ	T.11.03.0	3.18.787	7.(
								<u> </u>		<u> </u>				
						77.6		1						
	+	_	<u>В</u> Г	Цех	Уч.	PM	Опер Обозн	 ачение доку		наименование о	перации			
		H	Д					нование обо		ания				
			T				наименовани							
		_	Л/М			Наиме				и материала				
		$\vdash$	0		I		l	ие операции						_
			B 01			<u> </u>	030	1		монтаж ко				_
+		_	02	на пе	чатную	плату і	модуля п	рограмм	ирує	емой гирос	габили	заци	И	_
		_	03			<u> </u>	I							_
			Д 04				й дозато	p'ND-35						
			Д 05	_ ^	оскоп А									
			Д 06		_		ьная ста		EME	ENT 702				
-		_	Д 07	Стол	монтаж	ника Р	9A APM	-4110						
			Д 08	Унив	ерсальн	ый циф	ровой м	ультиме	гр М	9508				
			09				<u> </u>							
ŀ		+	T 10	Пинц	ет Инте	рмед Г	I-114							
			T 11	Брасл	тет анти	статич	еский ЈТ	-97-081						
			T 12	Tapa	 техноло	гическ	ая ДМВ	M8.870.0	001					
L			T 13	Боко	резы ТС	PEX 3	2D106							_
			T 14		Ī		і ый элект	ротехни	ческ	 ий.				
			15			1								_
			Л 16	Спира	⊤ Г этилов	_ ый рек	тификов	анный те	ехни	ческий «Эн	стра»	ΓΟΟ	Т	_
			17		78-2013									_
		_	Л 18				т ажные, са	алфетки	(400	х400) мм, (	200x20	00) м	м	_
		-	19		Γ 29298-	1			(	11 100) 11111, (		00) 1.1		
		╬	Л 20		т атки кап		TA TA	T						_
			21	ПСРЧ		ропоы								_
		F	22		I		I							
		╁	23		T		I	1						_
		H	24		T		Ι							_
			27	<u> </u>				ı						
		$\perp$						Разработа.	Л	Шитов Д.И.				
								Проверил Утвердил		Виноградов	А.И.			_
_		Э Д						Н. Контр						_
		πĖ						Отв. АЦП	У					_

				ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
					2
				ТЕИМ	C.11.03.03.18.787.00
			T	Код, наименование операции	
		-	Л/М	Наименование детали, сб.единицы или материала	
			О	Содержание операции (перехода)	Т
				1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
				1.1 К выполнению данной операции допускаются ли	ица:
Н				- не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмот	p,
				- изучившие техническое описание и инструкци	ию по
				эксплуатации установки;	
Щ				- прошедшие инструктаж и аттестованны	е на
					авилам
				эксплуатации электроустановок потребителей» и «Пра	
-				техники безопасности при эксплуатации электроустановок	
				- прошедшие инструктаж на рабочем месте с подпи	
				журнале инструктажа.	ilebio b
					онжом
				возникновение следующих видов опасности:	МОЖНО
				·	
				-электроопасность;	
-				-травмирование рук колюще-режущие предмета	ами и
Į				компонентами;	
				- пожароопасность;	
				- напряжение зрения.	
					орпуса
				установок, которые могут оказаться под напряжением в	-
				какой-либо неисправности (нарушение целостности зазем	
				или неисправной изоляции соединительных проводов и каб	5елей).
				1.4 Травмирование рук может возникнуть при каки	х-либо
				манипуляциях руками в рабочей зоне при выполнении р	абот с
				пинцетом, а также бокорезами.	
				1.5 Источником пожароопасности является эти	иловый
				спирт при наличии открытого огня или искры, термовозд	цушная
				паяльная станция, а также возможное воспламенение уста	ановок
				при их неисправности.	
Ду	В	П			
У Б	3 A	ОД			
Л		Л			
Ш		_			

						OCT 11.0	040.019-	83	Рорма 46	5	
											3
			-						МИ	ЭТ.11.03.03.18.	787.00 OK
	T			Код, наим	иенование (	операци	И				
	Л/М		Наи	менование детал							
	O			Содерж	кание опера	ации (пе	ерехода)	)			То
		1	.6 Источн	иком напр	яжения	зрен	ия яв	ляет	ся дли	ительная	
		работа с	с микроско	пом.							
		1	.7 Для об	еспечения	электро	безог	асно	сти г	геред	началом	
		работы	проверить	визуально	налич	ие и	целос	тнос	ть заз	емления	
		корпусс	в установ	ок пневмод	дозатор	аиу	нивер	саль	ной п	аяльной	
		станции	і, надежн	ость изоля	яции с	оедин	ителі	ьных	проі	водов и	
		кабелей	. Соблюда	ть требова	ания, и	зложе	нные	ви	нстру	кции по	
		эксплуа	тации этих	х установок	ζ.						
		C	облюдать	требовани	ия, изл	ожені	ные	в ин	нструк	ции по	
		«Охране	е труда при	и работе на	электро	оуста	новка	X».			
				бежание т							
				олнение ка							
		при про	оведении у	установкой	автома	атиче	ских	ЦИКЈ	іов. Е	3 случае	
		возникн		пасности	следуе	ет н	емедл	тенно	O OT	ключить	
		оборудо									
				ежание по							
		-		закрытом				над	пись	"спирт",	
			•	ельных при	•						
				бежание по			_			_	
				ез каждый	час ра	аооты	і дела	ать г	IMTTMI	инутныи	
		перерын		- E				- <u>~</u>	_		
			_	обнаружен		_		геи	в ус	становке	
		раооты	не произво	одить, вызв	ать нал	адчик	d.				
H 5 =											
Д В П У 3 О											
Б А Д —											
ЛМЛ											
	ОКУ		Опера	ционная карта у	/ниверсаль	ная					

					1			OCT 11.	040.019-	83	Рорма 46	5	
											МИ	ЭT.11.03.03.18.′	787.00
		_	T				именовани						
		_	Л/M О		На	пименование дет	али, сб.еди жание опе						
				2.	$OD\Gamma \Lambda 1$	деления ВИДАЕИН					TC A		
						тизация эке и монта						ю пноту	
					-		·				•	·	
				-	_	диомонтаж перации и и		_			теста		
						перации и и	імеющи	те квал	іифик	ацик	не ні	иже 4-10	
				разряда		ocarar v	у о от то	T 0 T1141			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T011110	
					-	абочем м						данная	
				_		арта, сборо		_					
					•	становки и		румен	г, а	такж	ce pa	сходные	
				_		итная экипі	-						
					.3 Электр		гигиена		•	/част		должна	
						гребования	•	аметра	ами ми	икроі	клима	га:	
						oa - (21,5±0							
						- (45±10)%							
						оты - 100, 1							
						ологическая		да пер	сонал	а уч	астка	должна	
Į						гребования						_	
						ологическое		орудов	вание	до	ОНЖПО	быть	
						но требова						_	
				2.		виды ремо		_	-		ческих	к работ	
				проводи			записьн	o pe	зульта	тов	В	журнале	
	-			_		рудования							
					.5 Перечо	•	филакт			рабо		и их	
				_	_	становлень	ы в экс	плуата	ацион	ной	докум	ентации	
				на устан	•								
					-	оль прив			-	ності	и ус	тановки	
				_	-	ор в следую	ощих сл	учаях	•				
				-	1 раз в не	делю;							
					-	ионта и про	_	-					
				- 1	повышен	ная дефекті	ность, п	ю указ	ванию	техн	олога	•	
Д У	B 3	П		<u> </u>				<u> </u>					
Б	A	Д -											
Л	M	Л											

т							(	OCT 11	040 019-9	3	ма 4б		
Т Кол, павыспование операции  Т Кол, павыспование операции  Т Кол, павыспование на материалыя  О Созержащие операции проводить в капроновых перчатках.  Капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакстах раздельно.  2.8 Радиоэлсктронные компоненты хранить и транепортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.											-23 10		_
Т Код. наименование операции  ЛМ Наименование детали, сб.единацы или материала  О Солержание операции (переходы)  Те 2.7 Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика.  Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.	-												5
П.М   Павменование детали, сб. единицы или материала											МИЭ	T.11.03.03.18	.787.00 O
Содержание операции (перехода)      Сл. Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках.      Капроновые перчатки надевать вне участка. Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно.      Сл. В Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.      Сл. В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.		T				Код, наг	 именование (	операци	и				
2.7 Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно.  2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.					Наим					ала			
капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно.  2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.		0											
	У 3 О		Хлог поли тране ситуа пара неме Даль излог	оновы Капр пчатоб вэтилен 2.8 спорти 2.9 ации метрон едленн ынейши	их перчатовоновые бумажны новых па Радиоэл ировать пожар в микро доложие его доложие его доложие в соо	перчамен салфет акетах развектронны в закрыто ае возни а, отклююклимата сить началействия д	атки ки и пер вдельно. е ко й технол икновени очение и т. пьнику у	наден рчатко мпон погиче ия на элект д.) ( участи	вать и хран еенты а уча проэне операт ка и в	вне нить на хра таре. стке прии, тору пызвать тр	уа уч анит внеп изм необ нал	участка. астке в ть и птатной менение ходимо адчика. ваниям,	
	БАД		+										
	JI MI JI												

							OCT 11.	040.019-83	3 Форма	4б	
									M	ИЭТ.11.03.03.18.7	787.00
		T				аименовани					
	-	Л/M О			Наименование д	етали, сб.еди сержание опе			ла		-
				3. Г	ІОДГОТОЕ				TA		
					готовка раб						
					едиться, чт					я станция	
			выключ	ены.							
			3	.1.2 Про	верить в	изуально	нал	ичие	и це.	лостность	
			заземле	ния авт	оматическо	го превм	иодоза	тора и	термов	оздушной	
			паяльно								
-	+			.1.3 Вкл		•	верит	ь ра	аботосп	особность	
				_	а и паяльно						
					ключить об					ісь о его	
					урнале готс						
					тотовка раб			_			
_					диться по						
					борудовани 						
				-	и проверена утствии заг					_	
				-	утствии заг работе не г						
					граооте не г гучить у те	•				,	
					ласно данн						
			_		(готовить	_	держа	_	рабочее	место,	
					· компонентн			•		1	
				ŕ			1		1		
i [											
	В П 3 О										
у Б	В П 3 О А Д М Л										

Т Код, наименование операции  Т Наименование детали, еб единиция вих материала  О Содержание операции (перехода)  4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  4.1 Подучить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.  4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхность печатной платы.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В завнеимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.							C	OCT 11.	040.019-	83 <b>4</b>	Рорма 4	Ю.	
т Код. пальенование операции  ПМ Наименование детали, сб сдиницы или материалы О Содержание операции (перехода)  4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  4.1 Подучоть рабочее место для монтажа компонентов.  4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.  4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3.1 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слетка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.													
											ΜI	ĬЭТ.11.03.03	3.18.787.0
Солержание операции (перехода)      4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС     4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов.     4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в еледующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.		T			К	од, наиме	нование о	пераці	и				
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС     4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов.     4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5.1 Гриступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.		Л/М		]	Наименован	ие детали	, сб.един	ицы ил	и матери	ала			
4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов.     4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; крутовыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку пітыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.	-	О											
4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	. TEXH	ОЛОГИ	ЧЕСК	ИЙ ПР	ОЦЕ	CC				
печатной платы у технолога.  4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.1 Подг	отовить	рабоче	е мест	о для	н монт	ажа 1	комп	оненто	В.
4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	1 Получ	ить ка	ссеты	с ко	мпоне	нтам	ииз	ваготові	ку
количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ечатной	платы у	техно.	пога.						
4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	2 Прове	рить	ПО	сопр	оводи	итель	ному	и лис	гу
технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			К	оличесті	во и соот	гветств	ие эле	ктро	нных	комп	онен	тов.	
4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	3 Прове	рить	налич	ие і	трочи	X Ou	ища	ющих	и
капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			T	ехнологі	ических	матери	алов.						
4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	4 Монта	ажнику	и надет	гь ан	гистат	ичес	кий (	браслет	И
компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			К	апронов	ые перча	атки.							
4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.2 Визуа	ально	провеј	оить	цело	остнос	сть	элен	строннь	JIX
4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.      4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.      4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.      4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.      4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.      4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			компон	ентов.									
следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.3 Прои	звести о	чистку	загот	овки	печат	ной г	ілать	I.	
бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.3.	1 Произ	вести	очио	стку	печа	атной	я́ п	латы	В
поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			c.	ледующ	ем поряд	дке: сл	егка п	ропи	гать х	лопч	атобу	умажну	то
протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			б	язь этил	овым сп	иртом;	круго	вымі	и двих	кения	ими п	ротере	ГЬ
печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	оверхно	сть пе	чатной	пла	ты	проп	итані	ной	тканы	o;
4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ротереті	ь чистой	і́ хлоп	чатобу	/маж	ной б	маєк	ПОВ	ерхнос	ТЬ
платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ечатной	платы.								
4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.4 Визуа	ально пр	овери	гь цел	остно	ость за	агото	вки	печатно	ой
монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			платы.										
4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.5 Прис	тупить	к опе	ерации	ПО,	дготов	вки	пове	рхності	Ю
части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			монтир	уемых к	омпонен	нтов.							
4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.5.	1 Раздел	лить г	ланку	ШТ	ыревы	X BI	илок	PLS 1	на
произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			Ч	асти бок	орезами	в соот	ветств	вии с	ПЭ.				
Д В П         У 3 О         Б А Д				4.5.	2 В зав	висимо	сти от	г ви,	да ра	зъема	a mi	cro US	$ \mathbf{B} $
ДВП УЗО БАД			п	роизвест	ги вырав	вниван	ие сило	овых	ноже	к пло	ског	убцами	.
У 3 O Б A Д			4	.6 Дозиј	рованно	е нанес	ение г	ірипо	ойной	паст	Ы.		
У 3 O Б A Д													
У 3 O Б A Д								ı					
	У  3   О												

								(	OCT 11.	040.019-	-83	Форма 4	4б	
														8
						I						М	жэт 11 02 02	19.797.00.01
												IVII	AЭТ.11.03.03.	.16./6/.000
		-	Т					именование						
		_	Л/M О			Наи	менование дет	али, со.един жание опер						To
		-			1	6 1 I	Томестит	•	`			IOTIII	ио столи	
				Ml	4. икросі			5 3410101	sky iic	чатно	JИ 11J.	іаты і	на СТОЛИ	
					4.	6.2	Установит	гь тюби	ік с	прип	ойно	ой па	астой н	ıa
				pa			нструмент							
				•			ND-35.							
Ц					4.	.6.3 I	Зключить	пневм	олоза	тор	нажа	в на	ь кнопк	·v
				<b>((</b> (	ON/OF				одози	Top				
-					4.	6.4	Вадать ог	тималы	ное и	колич	ество	о до	зируемо	й
				па	асты,	вра	щая руч	ку «Р»	). O	птима	льнь	MM (	считаетс	я
				ко	личес	тво,	при ко	тором 1	паста	пол	ност	ью з	заполняє	т
-				ко	энтакт	ную	площадк	у, и при	ЭТОМ	не ра	стека	ается	по мась	æ
				П	ечатно	й пл	ате.							
					4.	.6.5 I	Нанести	несколы	ко п	робнь	IX I	103 [	іасты н	ıa
-				П			ло конта			_				
				-			ания, убе	•		•		•		
							ькой КП.		,	r				
L							Удалить п	побные	лозы	чисто	й сх	хой б	วัสรษю	
							Троизвест	-			•			nR
				ПС			ажатием	_						
					_		ажатием 1-8) в вер:		•	_			-	/Y1
				111	_		_						_	
							Триступи		_		-			
							ечатной і							
				•	зных	_	вмеров,	-			•	ание	следуе	
							ичество д				_			
							нанесенну							й,
				cy			и повтор					мест	о.	
$\Box$					4.	6.9 (	Этключит	ъ авто	матич	іескиї	й п	невм	одозатој	p,
				На	ажав н	а кн	опку «ON	/OFF».						
	В	П								1	ı			
У Б	3 A	ОД												
Л	M	Л												

			ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
			МИЭТ.11.03.03.187	797 (
				707.0
		T	,	-
		O		
			4.7 Произвести контроль качества нанесения припойной	
			пасты. Неудачно, нанесенную пасту следует удалить чистой,	
			сухой бязью, затем снова нанести пасту на очищенный участок.	
			4.8 Приступить к операции дозирования клеевой	
			композиции.	
			4.8.1 Закрепить тюбик с клеем на рабочем	
			инструменте дозатора.	
-	$\dashv$		4.8.2 Включить пневмодозатор, нажав на кнопку	
			«ON/OFF».	
			4.8.3 Настроить дозу клеевой композиции опытным	
			методом, поворачивая ручку «Р». Количество дозы клея	
			должно быть таким, чтобы нанесенный клей на проекцию	
-			середины корпуса, самого мелкого компонента, не	
			растекался на контактные площадки этого компонента.	
-	$\dashv$		4.8.4 Запомнить дозировку клея, нажав на	
			произвольный номер программы (номер программы не	
			должен совпадать с номером программы при дозировании	
			припойной пасты) в верхней части дозатора.	
			4.8.5 Произвести нанесение клея, руководствуясь	
			шелкографическим рисунком на заготовке печатной платы.	
			Наносить пасту стоит на середину проекции корпуса на	
			ПП. Количество доз может меняться в зависимости он	
			площади и веса радиоэлектронного компонента.	
	$\dashv$		4.9 Произвести контроль качества нанесения клеевой	
			композиции. При наличии растекшегося клея, произвести его	
			очистку чистой, сухой хлопчатобумажной тканью в месте	
	$\dashv$		растекания. Затем, повторно нанести клей на это место.	
			4.10 Приступить к сборке компонентов на заготовку	
			печатной платы.	
Ду		П		
У Б	- 1	ОД		
Л	M			
_	_			<u> </u>

		ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
			10
		МИЭТ.11.03.03.18.7	/87.00 OI
	T	Код, наименование операции	
	Л/М	Наименование детали, сб.единицы или материала	
	0	Содержание операции (перехода)	То
		4.10.1 Удобно расположить кассеты с компонентами	
		на рабочем месте.	
		4.10.2 В соответствии со сборочным чертежом (СБ)	
		произвести сборку SMD компонентов на печатную плату.	
		Сборка SMD компонентов производится пинцетом. Для	
		удобства работы с мелкими чип компонентами можно	
		использовать микроскоп. Важно учитывать ориентацию	
		некоторых компонентов.	
		4.10.3 В соответствии со СБ произвести сборку	
		традиционно- монтируемых компонентов.	
		4.11 Операция контроля качества сборки печатной платы.	
		Визуально оценить качество сборки, сравнить ПП со сборочным	
		чертежом. При наличии дефектов или несоответствий,	
		произвести подгонку или переустановку компонента.	
		4.12 Монтаж компонентов на плату.	
		4.12.1 Включить термовоздушный паяльный фен, в	
		составе станции ELEMENT 702 переключив тумблер	
		«ПИТАНИЕ» в левой части паяльной станции в состояние	
		«ВКЛ».	
		4.12.2 Установить на минимум интенсивность	
		воздушного потока, повернув ручку «ВОЗДУХ» в крайнее	
		левое положение.	
		4.12.3 Установить температуру паяльного фена	
		равной 200 °C. Для этого, необходимо установить значение	
		«200» на левом цифровом индикаторе, используя кнопки	
		«ВВЕРХ» и «ВНИЗ», находящиеся под цифровым	
		индикатором.	
ДВП			
У 3 О Б А Д			
ЛМЛ			
	ОКУ	Операционная карта универсальная	

		ОСТ 11.040.019-83 Форма 4б	
			1
		MHXT110202	10 707 00
		МИЭТ.11.03.03.	18.787.00
	T	Код, наименование операции	
	Л/M О	Наименование детали, сб.единицы или материала  Содержание операции (перехода)	T
		4.12.4 Плавными круговыми движениям	
		обрабатывать поверхность печатной платы до начал	
		процесса кристаллизации клеевой композиции. Опытны	
		путем, и методом смещения компонентов пинцетом	
			1,
		определить затвердел ли клей.	
		4.12.5 Установить температуру термовоздушног	
		паяльного фера равной 240°С. 4.12.6 Плавными круговыми движениям	,,
		обрабатывать ПП горячим воздухом до момент	
		кристаллизации припойной пасты. Момен	
		кристаллизации можно определить визуально, припойна	R
		паста поменяет цвет и консистенцию.	
		4.12.7 Отключить термовоздушный паяльный фен	
		переключив тумблер «ПИТАНИЕ» в левой части паяльно	И
		станции в состояние «ВЫКЛ».	
		4.12.8 Дождаться момента, когда печатная плат	a
		остынет и приобретет комнатную температуру.	
		4.13 Произвести контроль качества монтажа.	
		4.13.1 Произвести визуальный контроль качеств	a
		паяных соединений.	
		4.13.2 При обнаружении дефекта монтажа следуе	
		провести его анализ и устранение. В процессе устранени	R
		дефекта необходимо пользоваться паяльником	1,
		присутствующем в составе паяльной станции.	
		4.14 Провести выходной контроль функциональност	и
		отдельных узлов ПП. Для этого необходимо использоват	ъ
		универсальный цифровой мультиметр. Порядок работы	c
		прибором Mastech M9508:	
ДВП УЗО			
У 3 О Б А Д			
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$			
	ОКУ	Операционная карта универсальная	

Т Кол, нависенование операция  ЛУМ Наисепование астоли, об салинцы или митериала  О Содержание операции (переходая)  То  4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN».  4.14.2 Установить щупы в гнезда «СОМ» и «V/Онт/Иг».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной провержемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и шитапие.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микроехемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микроехемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.			ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
Т Кот, наименование операции  ЛМ Наименование детали, сб.единицы или материала  О Содержане операции (перехода)  То  4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN».  4.14.2 Установить шупы в гнезда «СОМ» и «V/Оhm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.				12
			МИЭТ.11.03.03.18.78	7.00 OK
ММ   Наименование детали, еб.единицы или материала   То		T	Код, наименование операции	
4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN».  4.14.2 Установить щупы в гнезда «СОМ» и «V/Ohm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.		Л/М	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
«ОN».  4.14.2 Установить пупы в гнезда «СОМ» и «V/Ohm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°С от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.		0	Содержание операции (перехода)	То
нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°С от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.			4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ON».  4.14.2 Установить щупы в гнезда «COM» и «V/Ohm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.	10
	У 3 О Б A Д		нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время	
		_		